GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司



Global Family,
Global Solutions!

環球晶圓(6488TT)
2026年第三季營運報告

2026/11/03

Disclaimer

This presentation has been prepared by GlobalWafers Co., Ltd. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.

01

經營團隊重點報告

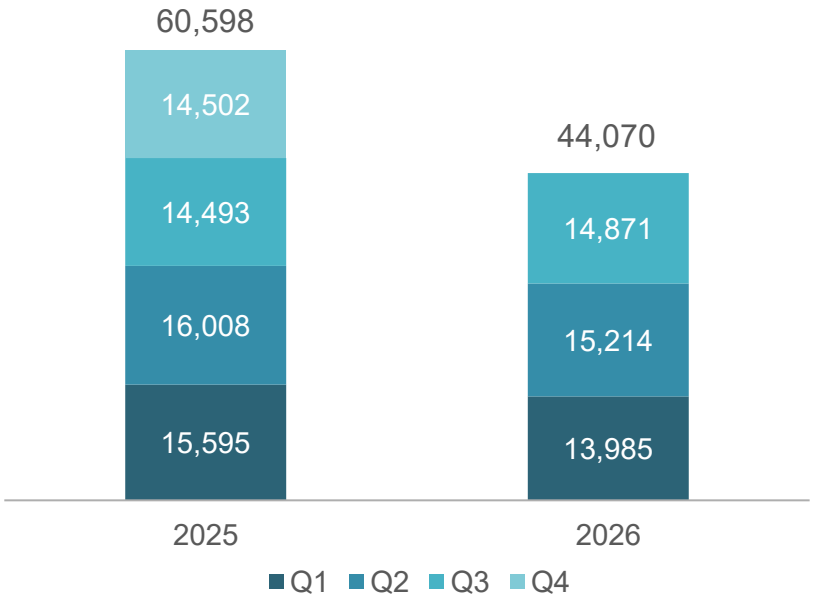
經營團隊重點報告

➢ 財務摘要

營業收入

- 2026年第三季→新台幣 149 億元，季減 2.3%
- 2026年累計前三季→新台幣 441 億元，年減 4.4%

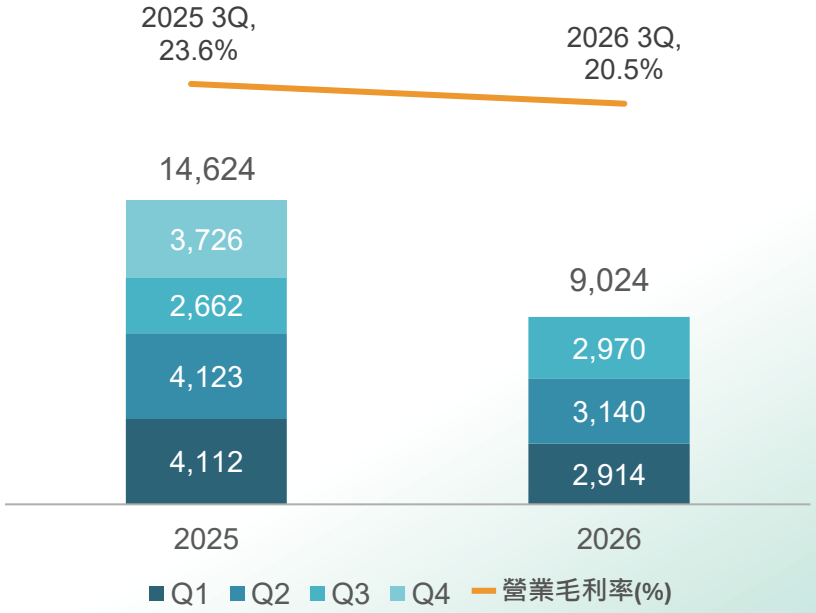
（新台幣百萬元）



營業毛利率

- 2026年第三季→20.0%
- 2026年累計前三季→20.5%

（新台幣百萬元）



© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

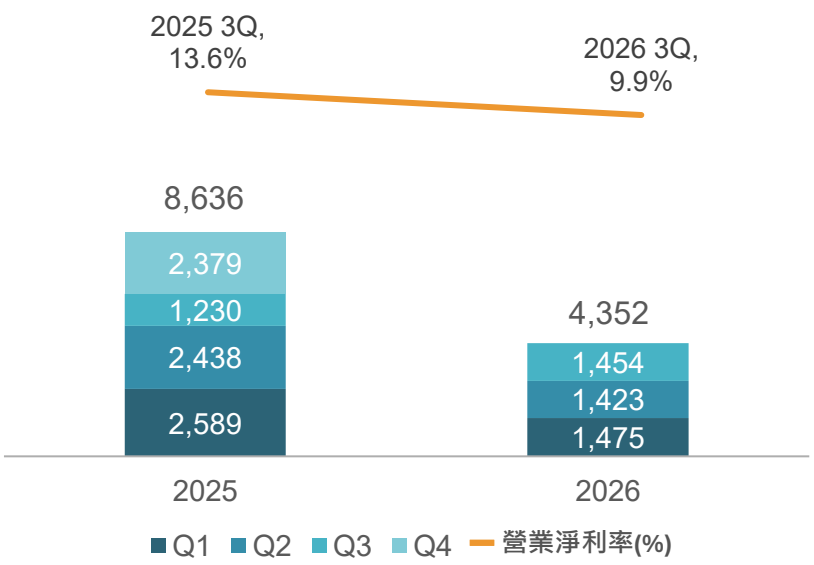
經營團隊重點報告

➢ 財務摘要

營業淨利率

- 2026年第三季→9.8%
- 2026年累計前三季→9.9%

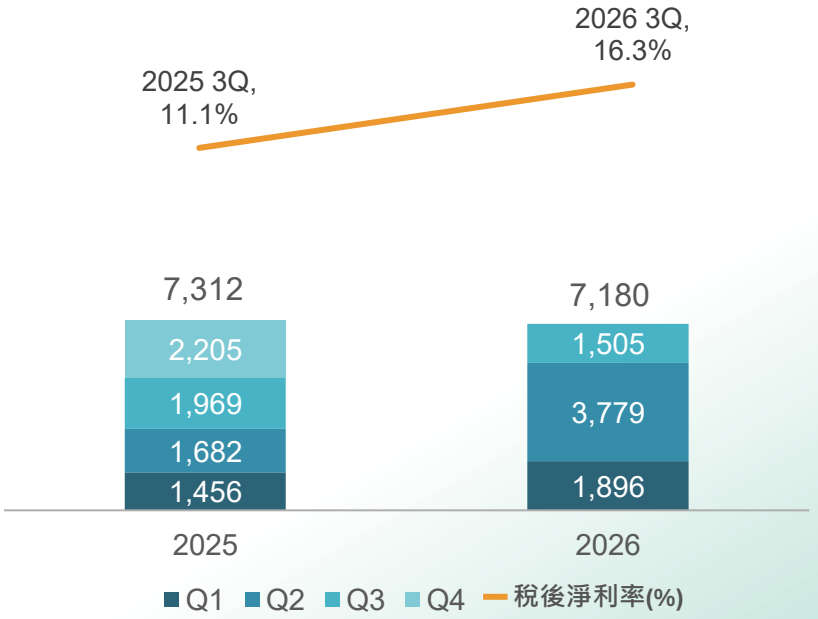
（新台幣百萬元）



稅後淨利率

- 2026年第三季→10.1%
- 2026年累計前三季→16.3%

（新台幣百萬元）



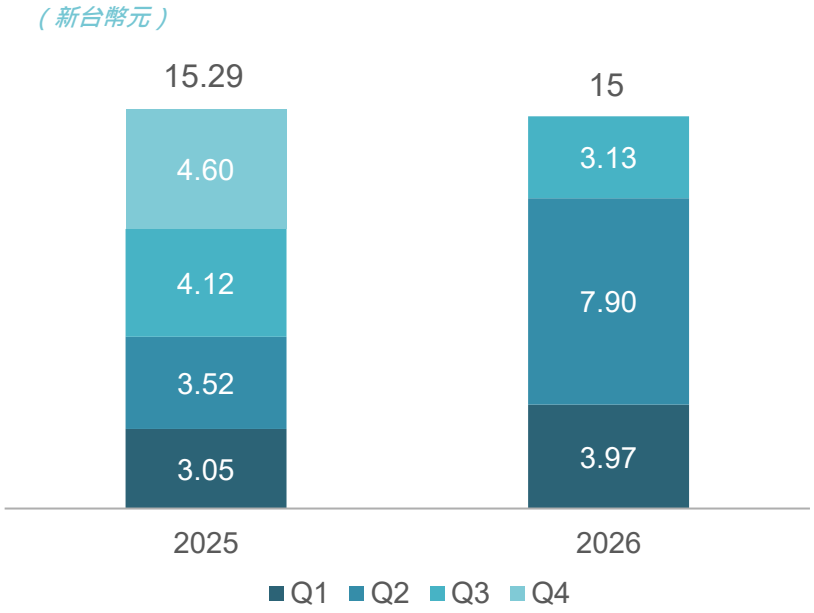
© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

經營團隊重點報告

➢ 財務摘要

每股盈餘

- 2026年第三季→新台幣 3.13 元
- 2026年累計前三季→新台幣 15 元



預收貨款

- 新台幣212億元（6.7億美元）[1]

擬配發股利

- 2026上半年股利 – 每股配發新台幣 6.0 元
- 2026上半年股利配發率 – 50.5%
- 除息基準日 → 2027年1月4日
- 股利發放日 → 2027年1月22日

備註：
匯率：新台幣兌美元 = 31.85，含保證金。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

經營團隊重點報告

➢ 產業概況

■ 兆美元半導體市場與晶圓需求成長，提升已通過認證、可立即量產之產能的策略價值

- ✓ **兆美元市場，需求持續擴大**——全球半導體市場規模預估於 2026 年突破 1.6 兆美元。AI、HBM 及先進運算為主要成長動能，隨著低成本、開放權重 AI 模型日益普及，AI 應用正從尖端模型擴展至更多企業及主權 AI 領域。成長動能亦由先進製程延伸至成熟製程的電源管理、連網及工業應用，並帶動 SOI、化合物半導體及特殊材料需求。

- ✓ **矽晶圓需求持續成長**——全球矽晶圓出貨量持續呈現年增，復甦趨勢逐步擴及不同尺寸晶圓。主要晶圓代工廠持續擴充次世代及既有先進製程產能，先進封裝技術亦增加每套系統所需的晶圓用量，未來市場供需關係可望逐步趨緊。

- ✓ **已認證量產產能的策略價值提升**——隨著 AI 帶動的需求維持強勁，晶圓代工及記憶體製造商持續推動多年期擴產計畫。然而，建廠成本高昂、設備交期及客戶認證週期較長，限制新增產能的供給速度，進一步凸顯既有且通過認證產能的價值。晶圓作為半導體製造不可或缺的基板材料，對生產良率及供應穩定性至關重要。隨著產業產能利用率提升，具備穩定供貨能力及客戶認證資格的晶圓供應商，其策略重要性將更加凸顯。

資料來源：WSTS（2026 年 8 月）

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

經營團隊重點報告

➢ 環球晶圓關鍵亮點

■ 儘管短期受到火災事件影響，穩健的營運執行力與提升的財務彈性，強化環球晶圓的長期競爭力

- ✓ **全球擴產效益逐步顯現，營運動能持續增強**——美國德州廠（GWA）連續四個月出貨創新高，密蘇里廠第三季 12 吋 SOI 產量創歷史新高。義大利 Novara 12 吋新廠持續提升產能，日本宇都宮及新潟廠第三季分別創下出貨量及營收新高。隨著既有各尺寸晶圓產能維持滿載，全球據點營運表現亮眼，展現過往擴產投資的成果。

- ✓ **深化美光策略合作，強化美國供應布局**——延續先前簽署的合作備忘錄（MOU），環球晶圓董事會通過擬發行上限 5 億美元、10 年期國內無擔保私募可轉換公司債，由美光科技（Micron）擔任唯一應募人。結合規劃中的 10 年期長期供貨協議（LTA），雙方合作將進一步支持環球晶圓在美國的業務拓展與供應能力，強化先進半導體晶圓供應鏈韌性，因應 AI、高效能運算及資料中心帶動的先進記憶體需求。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

經營團隊重點報告

➢ 環球晶圓關鍵亮點 (續)

■ 儘管短期受到火災事件影響，穩健的營運執行力與提升的財務彈性，強化環球晶圓的長期競爭力

- ✓ **財務結構轉為淨現金，提升長期競爭力**——環球晶圓於 9 月完成 14 億美元 GDR 發行，財務結構由淨負債轉為淨現金，顯著強化財務體質。本次募集資金將用於原物料採購及海外擴張，並結合環球晶圓跨越景氣循環、持續審慎投資的能力，以及全球製造布局優勢，使公司得以依據客戶承諾，推動既有廠區擴建（brownfield）與新廠建置（greenfield），同時為掌握下一波半導體產業成長週期做好準備。

- ✓ **12吋SOI需求強勁，支撐下一階段成長**——受惠市場由8吋轉向12吋，以及矽光子、RF-SOI與Power SOI需求成長，12吋SOI需求已超過既有擴產規劃。密蘇里州廠為美國唯一具備12吋SOI製造能力的生產基地，目前正透過去瓶頸化加速產能爬坡。環球晶圓亦正評估進一步擴產，並與多家客戶洽談長期供貨協議（LTA）及預付款安排，結合既有廠房與基礎設施優勢，提升資本效率，以審慎且具紀律的方式推動下一階段成長。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

半導體應用趨勢顯示成長具結構性支撐，超越景氣循環復甦

運算與AI基礎設施

結構性需求強勁

- AI 基礎設施投資持續加速，2026 年資料中心系統支出預估增加超過 60%，支撐先進製程矽晶圓的多年期需求。
- 先進製程晶圓代工資本支出維持高檔，未來數年投資預計進一步增加，以擴充先進製程產能，反映客戶持續投入的承諾。
- 隨著 AI 朝代理式 AI（Agentic AI）發展，除加速器外，CPU 與網路交換器需求亦再度攀升，增加每座資料中心的矽晶片使用量。
- 隨著低成本、開放權重模型推動 AI 更廣泛應用，相關需求正從頂尖 AI 研究實驗室及超大規模雲端服務業者，逐步擴展至更廣泛的市場。

記憶體市場

基本面穩健

- 記憶體預估將成為 2026 年成長最快的半導體領域，在 HBM 及 AI 伺服器需求帶動下，營收預計成長逾三倍。
- 記憶體市場供需持續緊俏，儘管產能不斷擴充，供應短缺情況預期仍將延續。
- 客戶日益積極簽訂長期供貨協議，提升中期晶圓需求的能見度。

智慧型手機與個人電腦

價值導向需求

- 記憶體成本高漲，預期將持續壓抑智慧型手機及 PC 出貨量至 2027 年。然而，平均售價（ASP）上升可望推升 2026 年市場產值，即使智慧型手機出貨量下滑約 17%，市場產值仍預估增加約 6%。
- 原始設備製造商（OEM）優先布局高階及 AI 功能裝置，帶動單機邏輯晶片、記憶體及射頻（RF）元件含量持續增加。
- 摺疊式手機仍是市場的成長亮點，但整體智慧型手機需求復甦仍不均衡。

資料來源：Gartner（2026 年 7 月）；WSTS（2026 年 6 月及 8 月）；IDC（2026 年 3 月及 8 月）；主要半導體及 AI 科技公司公開揭露資訊（2026 年 7 月至 10 月）；OpenRouter（2026 年 9 月）

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

半導體應用趨勢顯示成長具結構性支撐，超越景氣循環復甦（續）



車用與工業應用

需求漸進復甦，矽含量提升

- 工業需求逐步回升，主要由電網及電力基礎設施投資帶動；隨著客戶回補庫存，車用市場亦呈現漸進式復甦。
- 隨著軟體定義汽車（SDV）及先進駕駛輔助系統（ADAS）日益普及，每輛車所需的邏輯晶片、功率元件及感測器含量持續增加，形成結構性需求支撐。
- AI 資料中心電源解決方案及實體 AI（Physical AI）正成為新興的長期成長動能。



先進封裝

基本面穩健

- 先進封裝產能仍是供應鏈的主要瓶頸，限制客戶業務擴展，目前業界正積極擴充產能並開發次世代解決方案。
- 2.5D / 3D 整合技術，包括 CoWoS、CoPoS、HBM 堆疊，以及新興的共同封裝光學（CPO），正逐漸成為提升 AI 系統效能的關鍵。
- 隨著堆疊技術複雜度提高、規格要求趨嚴及良率損失增加，每套系統所需的晶圓用量隨之上升；同時，矽光子技術亦帶動 SOI 等特殊晶圓需求。

資料來源：環球晶圓內部市場研究（2026 年 9 月）；主要半導體公司公開揭露資訊（2026 年 7 月至 8 月）

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

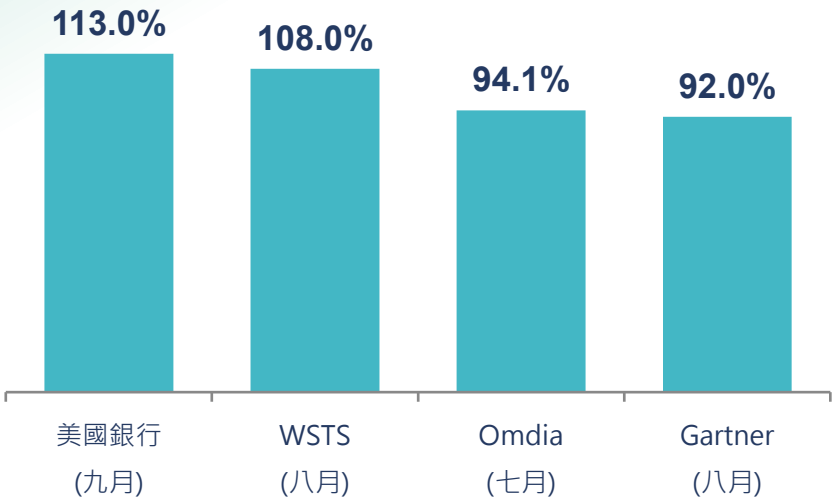
02

公司概况

全球半導體市場預測

主要研究機構均上調 2026 年市場預測，預期半導體市場規模將近翻倍，成長趨勢延續至 2027 年。

2026 年全球半導體營收年成長率（預測）



市場成長驅動因素

記憶體為市場成長核心動能

受 AI 需求及價格上漲帶動，記憶體營收占比預估將由 2025 年的 27% 提升至 2026 年的 54%，其中 DRAM 及 NAND 營收分別成長 247% 及 372%。

AI 正重塑半導體產業結構

AI 資料中心占比預估將由 2026 年的 36.5% 提升至 2030 年的逾 53%，帶動 CPU、網路、電源管理及類比晶片需求。

供應緊俏態勢延續至 2027 年

HBM、先進封裝及先進製程產能瓶頸，促使業者加速擴產投資。

2026 年半導體市場規模預測

1.56–1.66 兆美元

Gartner / WSTS

2027 年半導體市場規模預測

1.94–2.14 兆美元

Gartner / WSTS

2027 年全球晶圓廠設備支出預測

1,800 億美元

SEMI, 年增 14%

資料來源：美國銀行（2026 年 9 月）；WSTS 依據 2026 年第二季數據更新之市場展望（2026 年 8 月）；Omdia（2026 年 7 月）；Gartner（2026 年 8 月）；SEMI（2026 年第三季）

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

14 億美元 GDR 發行，支持全球布局並提升財務彈性

2026 年 9 月 22 日　　14.32 億美元

GlobalWafers Co., Ltd. 環球晶圓股份有限公司

GDR 發行

交易摘要[1,2]

發行規模：	14.32 億美元
發行價格：	每單位 GDR 28.64 美元（普通股約當新台幣 908.3 元）
折價幅度：	較前一交易日收盤價折價 6.46%
超額認購倍數：	約 4 倍
發行架構：	100% 發行新股
歷史地位：	台灣歷來第三大 GDR 發行案[3]
獨家全球協調人暨簿記管理人：	摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities plc)

GDR 發行前後財務狀況比較

	Q226		Q326	
淨現金	新台幣 -185.7 億元	→	新台幣 +263.1 億元	成長超過 200%
負債比率	56%	→	52%	-4 個百分點
流動比率	128%	→	163%	+35 個百分點
速動比率	108%	→	150%	+42 個百分點

資金投入，驅動成長

GDR 募集資金 14.32 億美元

原物料採購
外幣原物料採購及供應準備

未來發展契機
支持環球晶圓全球製造據點的未來發展

掌握長期發展契機
提供充裕資金，把握 AI、高效能運算及先進半導體應用帶動的強勁需求。

強化「在地製造、在地供應」全球布局
支持環球晶圓全球製造據點的未來發展，並提升在地製造能力，更有效滿足主要海外市場的客戶需求。

提升財務彈性
強化財務結構及資金流動性，提升公司投入擴產投資及因應產業景氣循環的靈活度。

擴大國際機構投資人持股基礎
拓展公司國際股東結構，提升全球機構投資人的關注度，並改善股票交易流動性。

註：1. GDR 發行申報文件；2. FactSet；3. Dealogic

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

環球晶圓布局就緒，迎接下一階段成長契機



需求多元擴展 → 營運準備就緒 → 審慎資本配置

需求復甦範圍持續擴大

- 各尺寸晶圓需求轉強
- AI 帶動先進及成熟製程需求
- SOI、GaN、12 吋 SiC 及方形晶片等先進與特殊晶圓商機增加
- 各應用市場以不同速度逐步復甦

擴產重要里程碑

- **美國德州謝爾曼新廠**
  連續四個月出貨量創新高
- **美國密蘇里州聖彼得廠**
  第三季 12 吋 SOI 產量創歷史新高
- **義大利諾瓦拉廠**
  12 吋新廠持續提升產能
- **日本宇都宮廠**
  第三季出貨量創歷史新高

14.32 億美元
GDR 發行成功完成

- 獲全球機構投資人踴躍認購，超額認購約 4 倍
- 提升財務彈性
- 支持環球晶圓全球製造布局的未來發展契機

環球晶圓領先景氣循環的前瞻性投資布局，
結合橫跨三大洲的一站式製造解決方案及更充裕的財務彈性，為掌握下一波半導體產業成長契機奠定堅實基礎

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

03

營運概況

財務摘要：2026年第三季 vs. 2026年第二季 vs. 2025年第三季

(單位: 新台幣百萬元，除每股盈餘)	2026年第三季	2026年第二季	2025年第三季	季成長	年成長
營業收入	14,871	15,214	14,493	-2.3%	2.6%
營業毛利 %	20.0%	20.6%	18.4%	-0.6p.p.	1.6p.p.
營業淨利	1,454	1,423	1,230	2.2%	18.2%
營業淨利 %	9.8%	9.4%	8.5%	0.4p.p.	1.3p.p.
本期淨利	1,505	3,779	1,969	-60.2%	-23.6%
本期淨利 %	10.1%	24.8%	13.6%	-14.7p.p.	-3.5p.p.
每股盈餘[1]	NT$3.13	NT$7.90	NT$4.12	-NT$4.77	-NT$0.99
EBITDA[2]	3,863	6,969	4,376	-44.6%	-11.7%
EBITDA %	26.0%	45.8%	30.2%	-19.8p.p.	-4.2p.p.
EBIT[3]	1,561	4,556	2,013	-65.7%	-22.4%
股東權益報酬率 (ROE[4] (年化))	5.0%	15.9%	9.0%	-10.9p.p.	-4.0p.p.
資產報酬率 (ROA[5](年化))	3.30%	8.15%	4.2%	-4.8p.p.	-0.9p.p.
資本支出[6]	3,214	2,202	7,018	-	-
折舊費用	2,297	2,408	2,357	-	-

備註: 1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內加權平均已發行普通股數量
2. EBITDA = 本期淨利+所得稅+利息+折舊費用+攤銷費用
3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息
4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益
*5. ROA = (本期淨利+利息費用 * (1-有效稅率)) / 平均資產*
6. Capex = 期末取得不動產、廠房及設備及預付設備款 - 期初取得不動產、廠房及設備及預付設備款

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

財務摘要： 2026年前三季 vs. 2025年前三季（累計）

(單位: 新台幣百萬元，除每股盈餘)	2026年前三季	2025年前三季	年成長
營業收入	44,070	46,096	-4.4%
營業毛利 %	20.5%	23.6%	-3.1p.p.
營業淨利	4,352	6,257	-30.5%
營業淨利 %	9.9%	13.6%	-3.7p.p.
本期淨利	7,180	5,107	40.6%
本期淨利 %	16.3%	11.1%	5.2p.p.
每股盈餘[1]	NT$15.00	NT$10.68	NT$4.32
EBITDA[2]	14,893	12,880	15.6%
EBITDA %	33.8%	27.9%	5.9p.p.
EBIT[3]	7,972	5,817	37.0%
股東權益報酬率 (ROE[4] (年化))	8.0%	7.5%	0.5p.p.
資產報酬率 (ROA[5](年化))	4.48%	3.4%	1.1p.p.
資本支出[6]	8,876	26,112	-
折舊費用	6,904	7,047	-

備註: 1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內加權平均已發行普通股數量
2. EBITDA = 本期淨利+所得稅+利息+折舊費用+攤銷費用
3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息
4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益
*5. ROA = (本期淨利+利息費用 * (1-有效稅率)) / 平均資產*
6. Capex = 期末取得不動產、廠房及設備及預付設備款 - 期初取得不動產、廠房及設備及預付設備款

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

損益表

新台幣百萬元	2025	Q126	Q226	Q326	3Q26	3Q26 (模擬)[1]
營業收入	60,598	13,985	15,214	14,871[3]	44,070	41,090
成長率(%)	*-3.2%*	*-3.6%[2]*	*8.8%[2]*	*-2.3%[2]*	*-4.4%*	*-*
營業毛利	14,624	2,914	3,140	2,970	9,024	13,520
營業毛利率(%)	*24.1%*	*20.8%*	*20.6%*	*20.0%[4]*	*20.5%*	*32.9%*
EBITDA	17,340	4,060	6,969	3,863	14,893	16,364
EBITDA率(%)	*28.6%*	*29.0%*	*45.8%*	*26.0%*	*33.8%*	*39.8%*
營業淨利	8,636	1,475	1,423	1,454	4,352	9,473
營業淨利率(%)	*14.3%*	*10.5%*	*9.4%*	*9.8%*	*9.9%*	*23.1%*
稅前淨利	9,516	2,347	4,585	1,690	8,622	10,583
稅前淨利率(%)	*15.7%*	*16.8%*	*30.1%*	*11.4%*	*19.6%*	*25.8%*
稅後淨利	7,312	1,896	3,779	1,505[5/6]	7,180	8,930
稅後淨利率(%)	*12.1%*	*13.6%*	*24.8%*	*10.1%*	*16.3%*	*21.7%*
每股盈餘（NT$）	15.29	3.97	7.90	3.13[5]	15.00	18.66

備註: 1. 模擬數係排除美國、義大利和日本的重大擴產計畫與持有 Siltronic 股份的市值變動影響
2. 營收季增率（QoQ）
3. 2026 年第三季營收較前季下滑，主要受到義大利 Novara 廠火災影響，以及其他廠區為支援 Novara 而進行產能調配所致
4. 2026 年第三季毛利率較前季下降，主要受到新產能爬坡帶來的成本及折舊增加，以及 Novara 火災後跨廠支援造成的產品組合變動影響
5. 2026 年第三季稅後淨利及 EPS 較前季下降，主要係因第二季認列較高的 Siltronic 持股市價評價利益，墊高比較基期
6. 2026 年第三季所得稅費用較前季減少，主要係因環球晶圓持有 Siltronic 股權之評價相關遞延所得稅調整所致

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

資產負債表

新台幣百萬元	2024	2025	Q126	Q226	Q326
資產					
現金及約當現金	38,929	19,484	24,128	23,776	60,800[3]
應收帳款	10,265	10,113	10,138	10,548	9,413
存貨	11,238	10,399	11,000	12,015	12,927[4]
不動產、廠房及設備	119,074	107,241	108,861	107,864	109,832[5]
其他資產	45,074	71,105	56,910	65,017	108,665
資產總計	**224,581**	**218,343**	**211,037**	**219,220**	**301,636**
負債					
短期借款[1]	28,797	31,010	33,887	38,282	77,203
應付帳款	5,371	4,161	3,867	4,697	4,356
長期借款[2]	37,678	43,244	29,221	33,188	31,931
其他負債	61,706	46,632	50,683	46,333	42,277
負債總計	**133,553**	**125,048**	**117,657**	**122,500**	**155,768**
權益總計	**91,028**	**93,295**	**93,379**	**96,720**	**145,868[6]**

現金資產細項包含:	
(新台幣百萬元)	**Q326**
三個月以上定存	6,514
受限制現金	61,791
債券	6,338

備註: 1. 短期借款包括短期借款、應付短期票券，以及一年內或一營業週期內到期的長期借款、應付公司債與應付可轉換公司債
2. 長期借款包括長期借款、應付公司債及應付海外附認股權公司債
3. 2026 年第三季現金及約當現金較前季增加，主要來自 GDR 發行募集資金，部分增幅則受到償還借款及資本支出抵銷
4. 2026 年第三季存貨較前季增加，主要因新擴廠區增購的物料及多晶矽陸續到貨
5. 2026 年第三季不動產、廠房及設備較前季增加，主要係因資本支出及匯率變動所致
6. 2026 年第三季股東權益較前季增加，主要受惠於 GDR 發行

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved.

04

Q&A